

# キュアログラフ H-1

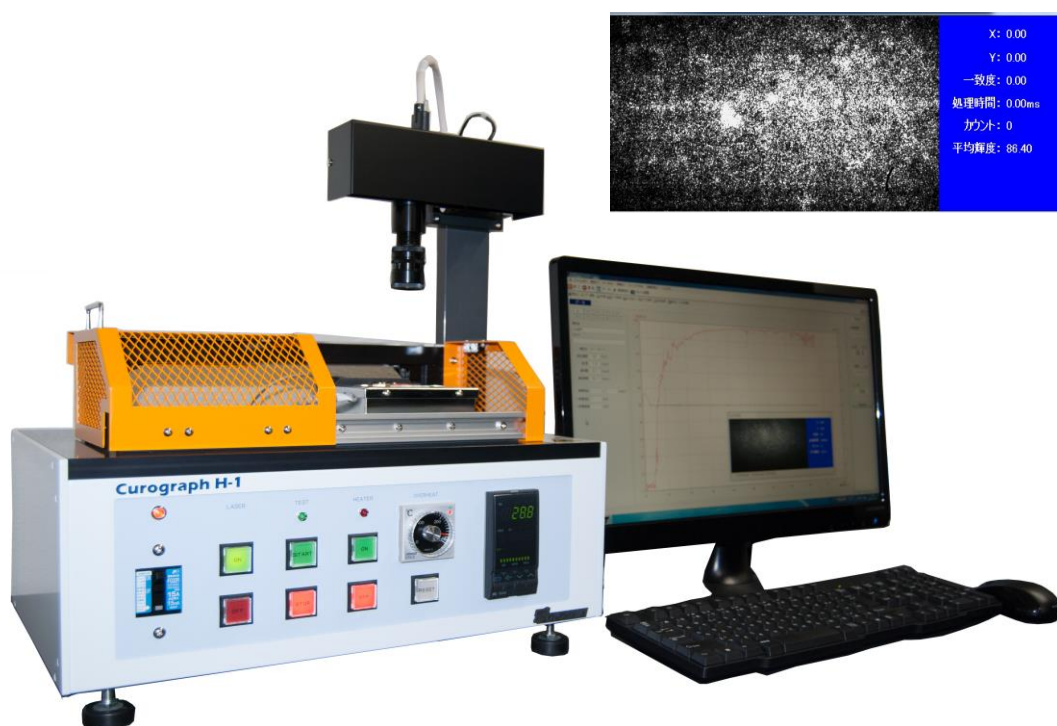
## Curograph H-1

### 用 途

#### 非接触 乾燥 硬化時間測定装置

塗料、インキ、接着剤などが乾燥、硬化する時間は、従来接触法により評価されてきました。この装置はレーザ干渉技術を応用した非接触法による測定装置で、試料表面にレーザ光を照射し反射光の中に生ずる斑点状の干渉縞模様を独自の画像処理技術により処理します。

これは試料の状態変化を評価する新しい測定法で、乾燥・硬化時間・軟化時間・表皮の乾燥状態などが測定可能で液体から固体、ゾル状からゲル状への変化など幅広い分野に適応できます。



### 特 長

- 非接触測定のため試料に負荷をかけず、傷もつけません
- リアルタイム計測しているため、乾燥、硬化の過程をその場で観察可能
- 熱板により試料に温度をかけた状態での測定が可能
- 計測間隔を変えることで速く硬化する材料から長時間で硬化する材料まで測定が可能<sup>NEW</sup>
- 反射光の明るさをレーザ出力を変えて自動調整することが可能<sup>NEW</sup>
- 画像を保存し計測間隔を変えた結果を再計算することが可能<sup>NEW</sup>

## 仕様

### 1. 計測時間

1分～1200時間  
ただし計測間隔によって変わる

### 2. 計測間隔

0.05～120秒

### 3. 光源 (レーザー)

赤色半導体レーザー  
発光波長 640nm クラス 3B  
最大出力 30mW未満

### 4. 測定結果

乾燥または硬化時間およびその過程 (グラフ)

### 5. 熱板

寸法: 150mm × 40mm  
材質: 真鍮

### 6. ヒータ容量

300W

### 7. 温度範囲

室温 又は 室温 + 20℃ ~ 300℃ (PID制御方式)

### 8. C-MOSカメラ

モノクロ 2560 × 2048画素 画素ピッチ5μm

### 9. データ処理装置

デスクトップ型パソコン OS Windows7/8/10 64bit版  
CPU Corei3以上, Memory 4GB以上, HDD 500GB以上  
CD-ROM, PCI-Express Lowprofile × 2, RS-232C回線 × 1  
モニタ 20インチ以上、プリンタ

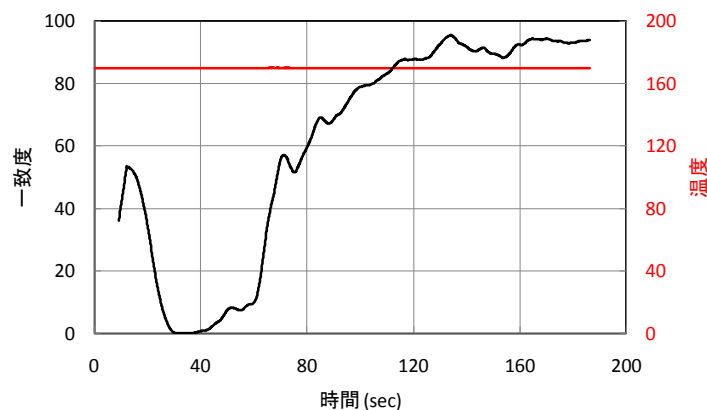
### 10. 電源

AC100V 単相 50/60Hz 10A

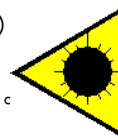
### 11. 機体寸法・質量

約W455 × D294 × H570mm 約20kg

熱硬化性樹脂の硬化測定 (熱板温度170℃)



この装置には半導体レーザーを使用しています (クラス3B)  
ご使用の際には次の点にご注意願います。  
レーザー光の直接光および反射光を直視しないでください。  
装置を分解しないでください。



#### レーザー照射

目への直接被ばくを避けること  
クラス3B レーザ製品

